

STANDARDLAGENAUFBAU HDI	
HDI12_2+8+2_1,55_35	12 - Lagen Kerne: 0,15 mm Cu 35/35 µm
WE-Artikel Nr.:	2 + 8 + 2
KUNDE:	



LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	
KUNDE	WE		
1	TOP/VS		
2	VSK1		
3	2		
4	3		
5	4		
6	5		
7	6		
8	7		
9	8		
10	9		
11	RSK1		
12	BOT/RS		

BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
			[µm]	[µm]
Folie	12 µm ¹⁾		12	
		1 x 1080	60	
Folie	12 µm		30	
		1 x 1080	60	
	35 µm		33	
0,150 mm			150	
	35 µm		33	
		2 x 1080	124	
	35 µm		33	
0,150 mm			150	
	35 µm		33	
		2 x 1080	124	
	35 µm		33	
0,150 mm			150	
	35 µm		33	
		2 x 1080	124	
	35 µm		33	
0,150 mm			150	
	35 µm		33	
		1 x 1080	60	
Folie	12 µm		30	
		1 x 1080	60	
Folie	12 µm ¹⁾		12	
Gesamtdicke Material:			1560	
Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)				

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

MATERIALDICKE: 1,55	+/-	0,13	mm	Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,64	+/-	0,16	mm	
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,70	+/-	0,18	mm	
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:

Erstellt am 28.03.2006	von S. Keller	Geprüft am 04.05.2006	von M.Kress	Freigegeben am 04.05.2006	von R. Schönholz	Revision 00	Seite: 5+
---------------------------	------------------	--------------------------	----------------	------------------------------	---------------------	----------------	-----------